

Editorial



Volker Pape



Dr. Martin Heuser

Liebe Leserinnen und Leser,

FastFlow, XM und XM-3D – Entwicklungen, die das Jahr 2013 bei Viscom technologisch geprägt haben. Zwei Stoßrichtungen werden dabei deutlich: Steigerung von Leistung und Durchsatz einerseits, Weiterentwicklung der 3D-Technologie andererseits. 3D-SPI, 3D-AOI, Inline-Tomosynthese, Offline-Tomographie und vieles mehr auf der Basis von 3D-Rekonstruktionen ist bei Viscom verfügbar.

Schon seit Beginn der AOI-Entwicklung nutzt Viscom verschiedene Ansichten zur Auswertung von 3D-Merkmalen, die zu kompletten 3D-Lösungen weiterentwickelt wurden. Und nicht zuletzt helfen moderne, intelligente Softwaretools, AOI leicht zu bedienen und zur Prozessoptimierung effizient zu nutzen. „AOI ist kompliziert“ gilt schon lange nicht mehr – besonders bei Viscom.

Mit freundlichem Gruß



Volker Pape
Vorstand Viscom AG



Dr. Martin Heuser
Vorstand Viscom AG



XM-3D-Keramomodul und Viscom Quality Uplink kommen gut an

Großer Andrang auf der Productronica

Unter dem Messemotto „Total 3D“ traf Viscom auf der Productronica mit der Präsentation des neuen 3D-AOI-Keramomoduls und dem Quality Uplink ins Schwarze. Vom 12. bis 15. November herrschte Hochbetrieb auf dem präsentablen Stand in der ersten Reihe der Halle A2. „Vom ersten Tag an haben sowohl die steigende Nachfrage nach 3D-Lösungen, als auch das generell große Interesse an hochwertigen Inspektionslösungen für Andrang gesorgt“, sagt Volke Pape, Vorstand für Vertrieb, internationales Geschäft und Unternehmensentwicklung. „Wir konnten die Besucherzahl noch einmal um rund ein Drittel zur letzten Productronica steigern. In vielen Gesprächen mit Messebesuchern standen unsere umfassenden 3D-Lösungen und der Viscom Quality Uplink im Mittelpunkt.“

Viscom deckt inzwischen den gesamten Fertigungsprozess mit 3D-

Inspektionslösungen ab: von der Lotpasten- bis zur Röntgeninspektion. Die volle 3D-AOI ergänzt dabei die leistungsstarke 2D-Inspektion, mit der bereits der weitaus größte Teil aller Fehler abgedeckt wird. Ihren Einsatz findet sie insbesondere bei Fehleraus-

Fortsetzung auf Seite 2 ►

Inhalt	
Unternehmen	
■ Productronica	Seite 1-2
Produkte	
■ 3D-Technologie	Seite 3
■ 3D-Lotpasteninspektion	Seite 5
■ Viscom S3088 CCI	Seite 6
Fachartikel	
■ Viscom Quality Uplink	Seite 3-4
Veranstaltungen	
■ Handball HSG Badenstedt	Seite 6
■ KiWiZ-Forscherpreis 2013	Seite 7
■ 9. Hannover Firmenlauf	Seite 7

◀ Fortsetzung von Seite 1



Mirko Weißgerber erläutert den Verifikationsplatz

prägungen wie Tombstoning, Koplana-ritätsprüfungen oder der Lifted Lead Detektion. Eine besonders positive Eigenschaft ist die einfache Programmierung und die unmittelbar verständliche Messtechnik der 3D-Merkmale. „Das Feedback der Messebesucher hat bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sieht auch Torsten Pelzer, Vertriebsleiter bei Viscom. „Unser langjähriges Engagement mit der Zielrichtung ‚Null-Fehler-Inspektion‘, d. h. höchste Prüftiefe, auch bei immer kleinerer Bestückung und anspruchsvollsten Prüfaufgaben, hat sich gelohnt.“

Groß war das Interesse vor allem am neuen XM-Kameramodul. Das Modul war im Live-Betrieb in einem S6056 AOI-System zu sehen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Gigabit pro Sekunde ist es eines der schnellsten AOI-Kamerasysteme auf dem Markt.

Bereits mit Hilfe geneigter Kameraansichten aus unterschiedlichen Blickrichtungen ließen sich elektronische Baugruppen über die Auswertung der 3D-Merkmale sehr zuverlässig inspizieren. Mit dem XM3D-Modul hält die 3D-Messtechnik Einzug in die AOI End-of-Line-Inspektion. Durch vollständige 3D-Auswertung und Bildinformationen aus – wie bisher schon – bis zu neun verschiedenen Kameras sind Fehler im Fine-Pitch-Bereich noch sicherer zu erkennen. Für maximale Präzision in der 3D-Messtech-

nik sorgt ein integrierter Streifenprojektor mit programmierbarer Projektionsauflösung, Frequenz und Phasenverschiebung.

Mit einer Auflösung von wahlweise 8 oder 16 μm pro Pixel und einer vierfarbigen Ausleuchtung lassen sich kleinste Details an miniaturisierten Bauteilen erkennen. Die hervorragende Bildqualität und die hohe Auflösung ermöglichen auch die zuverlässige Inspektion von 03015-Bauteilen. Durch die flexible Konfiguration der Kameras und des Projektors sind vorhandene AOI-Systeme mit der 3D-Technologie sehr einfach nachrüstbar.

„Der Markt verlangt einerseits nach hochwertigen Inspektionssystemen, die den steigenden Anforderungen an Miniaturisierung und Durchsatz gerecht werden. Zusätzlich besteht aber ein extrem hoher Bedarf, den gesamten Prozess zu evaluieren“, führt Volker Pape weiter aus. „Deshalb stieß der Viscom Quality Uplink ebenfalls auf großes Interesse. Dieser von Viscom entwickelte Ansatz erlaubt es, den Prozess intelligent zu bewerten und sogar zu regeln.“ Über den Quality Uplink kommunizieren alle Prüfsysteme miteinander, um ihre Ergebnisse zur Prozesskontrolle zusammenzuführen. „Die Verknüpfung der Informationen aus Lotpastenprüfung und End-of-Line-AOI ermöglichen es zum Beispiel, am Verifikationsplatz Fehler zuverlässiger zu klassifizieren und die Inspektionsaufgaben der einzelnen Prüftore optimal auf die Inspektionsobjekte auszurichten. Der First Pass Yield steigt, die Fertigungskosten sinken“, so Pape weiter. „Bis hin zur Steuerung der AOI- oder AXI-Prüfung anhand der Daten aus SPI ist vieles möglich.“

Neben den Highlights 3D-Technologie und Quality Uplink stellte Viscom natürlich das gesamte Produktportfolio vor:

AOI-Systeme (Automatische Optische Inspektion), Draht-Bond-AOI-Prüfung, 3D-SPI-Inspektion (Solder Paste Inspection) sowie automatische (AXI) und manuelle (MXI) Röntgeninspektionssysteme.



Volker Pape beim CEO Roundtable

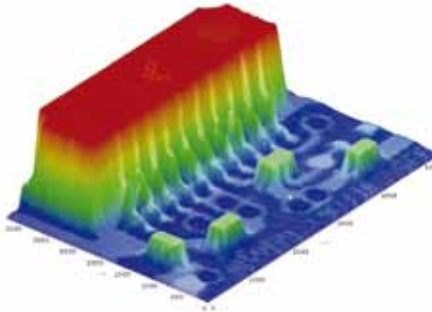
Unter anderem zeigte Viscom ein S3088 SPI System für die 3D-Lotpastenkontrolle in Verbindung mit dem DEK Lotpastendrucker Horizon und dem Viscom Quality Uplink im Live-Betrieb. Zudem waren auch das leistungsstarke Inline-Röntgeninspektionssystem X7056 und die X8011 PCB für die Offline-Röntgeninspektion zu sehen. Die X8011 PCB ist speziell ausgerichtet auf die Anforderungen in der SMT und kann auch mit der Uplink-Funktion ausgestattet werden. Darüber hinaus wurden auch alle Möglichkeiten der Drahtbond-AOI an dem Desktopsystems S2088BO-II gezeigt. „Mit Inspektionssystemen vor Ort fällt es leicht, Besucher von unseren Möglichkeiten zu begeistern“, so das Fazit von Volker Pape. „Für uns steht fest: electronica 2014 und vor allen Dingen productronica 2015 sind für uns gesetzt!“



Tino Mißbach präsentiert die S6056 mit XM-3D

Die zukunftssichere Inspektionslösung

Viscom S6056 mit 3D-Technologie



Viscom XM-Kameramodul mit 3D-Vermessung

Seit nahezu 30 Jahren entwickelt Viscom innovative Lösungen für die optische Inspektion und Röntgenprüfung. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden werden die Prüfsysteme an den neuesten Trends und Anforderungen in der SMT-Fertigung ausgerichtet. Von Anfang an war die Inspektionstechnologie dabei auch für die Prüfung von 3D-Merkmalen ausgelegt. So z. B. in der 3D-Lotpasteninspektion oder den 3D-Funktionen der Offline- und Inline-Röntgeninspektion bis hin zur kompletten μ CT. Jetzt hat

Viscom den neuesten Baustein zur Erweiterung des 3D-Leistungsumfangs, die 3D-Funktion im AOI-Hochleistungskameramodul XM, vorgestellt.

Um auch den neuen und zukünftigen Anforderungen in der Elektronikfertigung gewachsen zu sein, ist es nicht nur notwendig, das Prüfobjekt als Ganzes sicher zu erkennen, sondern jeden einzelnen Punkt des Objektes zu identifizieren. Diese Aufgabe ist in dem XM-Modul gelöst.

In der 3D-Funktion werden bis zu neun Bildansichten aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit Hilfe eines optionalen Streifenprojektors ausgewertet und 3D-Analysen im gesamten Bildfeld realisiert. Damit ist insbesondere bei der Lifted-Lead- und der Chip-Auflieger-Prüfung sowie der IC-Koplanaritätsinspektion eine noch exaktere Bewertung möglich.

In Verbindung mit dem leistungsstarken XM-Modul stellt diese Konstellation eine optimale Verbindung aller Einzelmessprinzipien im AOI-Bereich her und schafft so ein umfassendes optisches Inspektionssystem. Mit einer Bildaufnahme rate von bis zu 2 Gigabit/s ist das neue XM-Modul extrem schnell und dank zusätzlich hoher Auflösung, in der Lage, alle Informationen in eine hochgenaue 3D-Inspektion, mit höchster Geschwindigkeit umzusetzen.

Die neue Kameratechnologie ist ab sofort für die S6056 XM erhältlich. Viscom-Kunden profitieren von dem 8M-Kompatibilitätsmode. Diese Funktion stellt sicher, dass bereits vorhandene Prüfmuster und komplette Bibliotheken des 8M-Kameramoduls weitgehend ohne Änderungen übernommen werden können und so von der Geschwindigkeitssteigerung profitieren. ■

Viscom Quality Uplink

Die 5 Stufen zur effektiven Prozesskontrolle

Effektivität spielt nicht nur beim Einkauf, der Logistik und den Arbeitsabläufen eine große Rolle. Auch im Hinblick auf das Prüfkonzept und den Einsatz von AOI- und AXI-Systemen wird durch eine Vernetzung von Informationen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil erzielt. Der Viscom Quality Uplink vernetzt SPI, AOI, AXI und MXI. Das vermeidet Humanschlepp, reduziert Fertigungskosten und steigert den First Pass Yield.

Zu den Features des Viscom Quality Uplinks gehört zunächst einmal die Closed Loop Anbindung an den Pastendrucker. Die SPI kann so eine automatische Korrektur des Lotpastendrucks herbeiführen oder Reinigungszyklen optimieren. Darüber hinaus bietet Viscom im Rahmen der Programmerstellung die Überprüfung des Stencil Designs. Auch die Forward Loop der automatischen Korrektur der Bestückung ist möglich. Schaut man von

der 3D-SPI nun in Richtung end-of-line Prozess, bietet der Quality Uplink durch die Verkettung der SPI-Informationen mit Post-Reflow-AOI, AXI oder MXI eine Optimierung des SMT-Prozesses in fünf Stufen.

Stufe 1, der Image-Uplink: Im ersten Schritt werden die SPI-Fehlerbilder als Bitmap an den Post-Reflow-Klassifikationsplatz übertragen. Nach der abgeschlossenen AOI-Fehlerverifikation werden zu-

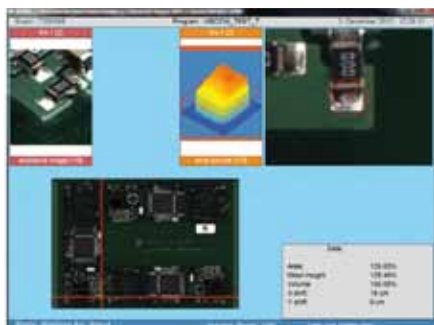
Fortsetzung auf Seite 4 ►

◀ Fortsetzung von Seite 3

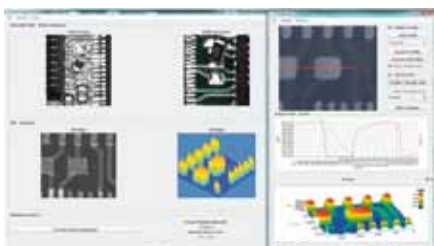
sätzlich die SPI-only-Fehler im Nachgang angezeigt. Das sind die Fehler, die am SPI detektiert werden, aber am AOI nicht mehr auffällig wurden, da sie sich im Prozess korrigiert haben. Hier unterstützt der Image Uplink den Operator bei der Verifikation der angezeigten Lötstelle.



Paste-Uplink AOI: Verknüpfung der SPI-Bilddaten, Prüfergebnisse & Messwerte mit AOI/AXI Daten zur Darstellung am Nachklassifikationsplatz



Zusatzbildaufnahmen vom SPI werden als fehlerhaft geprüfte Lotdepots am AOI/AXI im „Nachlauf“ generiert



Process-Uplink: Datenaufbereitung und -verknüpfung aller Prüftore (SPI/AOI/AXI) – PCB Datenbereitstellung zur ganzheitlichen Betrachtung

Stufe 2: Mit dem Pasten-Uplink bietet Viscom die Möglichkeit, im Rahmen der AOI- oder AXI-Fehlerklassifikation auch die Ergebnisse der Pasteninspektion optional anzuzeigen. Für alle Lötstellen einer betroffenen Bauteil-ID stehen 3D- und 2D-Pasteninformationen und -merkmale unabhängig vom SPI-Prüfergebnis

zur Verfügung. Zusätzlich können auch die Informationen aller Nachbarlötstellen abgerufen werden. Der Vorteil ist die weitestgehende Vermeidung von Fehlerklassifikationen (Humanschlupf) bei der Ergebnisverifikation der Lötstellenprüfung.

Stufe 3: Beim Solder-Uplink werden von SPI-only-Fehlern und/oder SPI-Grenzfehlern automatisch zusätzliche Bilder der fertigen Lötstelle aufgenommen. Hier wird das Feature der Viscom 3D-SPI angewandt, in der sogenannte „Warnings“ generiert werden können: Zusätzlich zu der Kategorie „Sicher Gut“ und „Sicher Schlecht“ gibt es die besonders beim Pastendruck durchaus relevante Gruppe von Pastenauftrag im Grenzbereich. Diese Ansichten können orthogonal, geneigt, in 2D, 3D und in Farbe aufgenommen werden. Zusammen mit den Detailinformationen aus der SPI-Prüfung liefern sie klare Hinweise darauf, wie bestimmte Auffälligkeiten sich nach der Verlotung verhalten haben. Die Zusatzbilder können dabei sowohl vom AOI als auch vom AXI oder MXI kommen. Durch diesen Abgleich ist es einfach, die optimale Prüfstrategie zu entwickeln und die Ressourcen optimal einzusetzen.

Stufe 4, TITUS-Uplink: Wie bereits beim Solder-Uplink angesprochen, unterscheidet Viscom bei der Pastenprüfung zwischen Grenzfehlern und definitiven Echtfehlern, d. h. Spezifikationsverletzung. Beide Grenzen können je Bauform unabhängig voneinander definiert werden. In Abhängigkeit von den Pastenmesswerten kann mit dem TITUS-Uplink jetzt die Prüfstrategie unter Einbeziehung der AOI-Prüfung online definiert werden. Die Regeln können z. B. produkt- oder bauteilbezogen festgelegt werden. Die Konfiguration erfolgt am Viscom-SPI, bestimmt z. B. welcher Prüfschritt wann adressiert werden

soll. Je nach Prüfergebnis können damit bestimmte Prüfschritte eingespart bzw. aktiviert werden. Der Vorteil: Pseudofehlerreduktion, Qualitätssteigerung und Erhöhung der Effizienz.

In der **5. Stufe** können mit dem Prozess-Uplink alle relevanten AOI-, SPI-, MXI- und AXI-Daten für die spätere Prozessanalyse und Qualitätsoptimierung gespeichert werden. Unter Verwendung des Viscom Uplink Prozess Analyzer (VUPA) können im Nachgang alle aufgetretenen Fehler an einem Offline-PC analysiert werden. Die Funktionen bieten direkte Rückschlüsse auf das Lötergebnis und die zugehörigen Pastenprüfergebnisse. So kann der Prozess-Uplink direkt zur Definition von optimierten Fehlergrenzen beitragen. Der Vorteil ist die Senkung der Kosten, eine Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie eine lückenlose Dokumentation.

Last but not least schafft das breite Portfolio von Viscom auch die Möglichkeit, neben der Einbindung der AOI- und AXI-Ergebnisse die Prüfergebnisse der MXI-Anlagen (Offline-Röntgeninspektion) in den Uplink einzubinden. Alle Prüfdaten aus der Viscom 3D-Lotpasteninspektion können auf dem Verifikationsplatz angezeigt und mit den Bildern der Röntgeninspektion abgeglichen werden.

Der Viscom Quality Uplink ermöglicht es damit Prozessgrenzen besser auszuloten und alle Inspektionsdaten und -ergebnisse so zu verknüpfen, dass sie dort verfügbar sind, wo sie gebraucht werden. Das schont wertvolle Ressourcen und optimiert die Fertigungskosten. ■

Viscom-Download

Einen ausführlichen Fachartikel zum Thema finden Sie unter:
www.fachartikel.viscom.com

Marquardt setzt auf Viscom S3088 SPI und Quality Uplink

3D-Lotpasteninspektion mit Prozessoptimierung

Die Marquardt GmbH, einer der führenden internationalen Hersteller von elektromechanischen und elektronischen Schaltern und Schaltsystemen aus dem schwäbischen Rietheim-Weilheim, setzt das 3D-Lotpasteninspektionssystem Viscom S3088 SPI ein. Das System erfasst alle wesentlichen 3D-Merkmale des Lotpastendrucks auf elektronischen Baugruppen, zum Beispiel Höhe, Form, Versatz, Verschmierung oder Verunreinigung des Drucks. Mit dem Viscom S3088 SPI System ist Marquardt in der Lage, die Qualität des Lotpastendrucks zuverlässig und mit hoher Geschwindigkeit zu prüfen. Darüber hinaus bietet das System eine einfache Bedienung und mit dem Quality Uplink ein effizientes Werkzeug zur Prozessoptimierung.

Die Mechatronik-Kompetenz von Marquardt kommt vor allem im Automobil, Elektrowerkzeugen, Haushaltsgeräten und Industrieanlagen zum Einsatz. „Wir fertigen unsere Produkte in hohen Stückzahlen. Im Betrieb sind sie durch häufiges Schalten oft stark beansprucht. Qualität ist deshalb der entscheidende Faktor in unserer Fertigung“, sagt Holger Gerst, verantwortlich für die AOI/AXI-Prüfsysteme bei Marquardt.

„Mit dem Viscom S3088 SPI Lotpasteninspektionssystem erkennen wir Fehler bereits vor der Bestückung der elektronischen Baugruppen. Damit senken wir die Kosten der Weiterverarbeitung.“

Nachdem sich Marquardt entschlossen hatte, ein System zur 3D-Lotpasteninspektion einzusetzen, hat das Unternehmen über ein halbes Jahr verschiedene Lieferanten evaluiert. „Eigent-



Mathias Jerger (links) und Nico Schmid betreuen die AOI-Systeme bei Marquardt. Sie haben das Viscom S3088 SPI System für die 3D-Lotpasteninspektion integriert.

lich hatten wir uns bereits anderweitig festgelegt, als wir am Ende des Auswahlprozesses noch einmal das Viscom System betrachtet haben“, berichtet Holger Gerst. „Überzeugt hat uns neben der sicheren Inspektion letztendlich, dass dieses System bereits die Ausschreibung für ein anspruchsvolles Förderprojekt der EU gewonnen hatte und dass wir mit Viscom individuelle Anpassungen erarbeiten und im System umsetzen konnten.“

Insgesamt hat Marquardt mit der Viscom S3088 SPI den Druckprozess deutlich stabilisiert, da sich alle Druckparameter schnell und exakt anpassen lassen. Es fällt zum Beispiel sofort auf, wenn der Drucktisch nicht richtig kalibriert oder die Leiterplatten nicht perfekt ausgerichtet sind, da das System die Folgeeffekte sofort analysiert, erkennt und den Operator informiert. „Zudem wissen wir jetzt genau, wie lange wir eine Scha-

blone bis zur nächsten Reinigung einsetzen können“, berichtet Holger Gerst. „Dies reduziert den Linienstillstand und stabilisiert die Qualität der Fertigung auf hohem Niveau.“

Und er erläutert weiter: „Als besonders vielversprechend stellte sich die Möglichkeit der Verknüpfung der SPI-Ergebnisse mit den EOL AOI-Ergebnissen dar, die wir in Zusammenarbeit mit Fa. Viscom noch bei uns installieren werden. Bisher haben wir die notwendigen Konfigurationsparameter mit Fa. Viscom für unsere Linienkonfiguration ermitteln können. Als nächstes wird hierzu bei uns die Installation der Quality Uplink Funktion auf eine Produktionslinie eingeplant. Wir erwarten dadurch eine Reduzierung vom Ausschuss, eine Verbesserung vom First Pass Yield und damit eine Verbesserung vom gesamten SMT-Prozess.“ ■

Viscom S3088 CCI

Zuverlässige Schutzlackprüfung elektronischer Baugruppen

Transparenter Schutzlack bewahrt elektronische Baugruppen vor Schäden durch Feuchtigkeit und Nässe. Das neue Inspektionssystem Viscom S3088 CCI (Conformal Coating Inspection) prüft Lackierungen schnell und zuverlässig auf typische Fehler wie Risse, Fehlstellen, zu dünne oder zu dicke Schichten, Verschmierungen, Verunreinigungen oder Spritzer. Voraussetzung ist der Einsatz durchsichtiger Lacke, die ultraviolettes Licht (UV-Licht) reflektieren. Das System Viscom S3088 CCI verfügt über eine 8M-Sensorik mit vier orthogonalen Kameras. Zusätzlich ist die Sensorik mit UV-LEDs ausgestattet. Die S3088 CCI Systeme sind ab sofort weltweit verfügbar.

Elektronikfertiger setzen die Viscom S3088 CCI am Ende der Prozesskette nach dem Lackieren und Trocknen ein. „Das neue Inspektionssystem für die Prüfung des Conformal Coating ist fester Bestandteil der Viscom Produktfamilie. Die S3088 CCI arbeitet mit der Viscom SI-Inspektionssoftware und bietet damit sowohl

dieselbe Bedienoberfläche als auch dieselbe Programmierstrategie“, sagt Detlef Beer, verantwortlich für die Produktentwicklung bei Viscom. „Auf dieser Grundlage lassen sich Traceability-Konzepte, Sonderprüfungen wie das Lesen von Etiketten mit Data Matrix Code (DMC) oder weitere Features umsetzen. Das System ist damit ebenso in Produktionssystemen, so genannte Manufacturing Execution Systemen (MES) integrierbar“.

Technologisch basiert die S3088 CCI auf der erprobten Viscom-Systembasis. Das System arbeitet mit UV-LEDs, die UV-sensitiven Schutzlack gut zum Hintergrundmaterial kontrastieren lassen und ist damit in der Lage, die Konturen des Lacks klar zu erkennen. „Bei einer Auflösung von 11,7 oder 23,5 µm/Pixel sind auch kleinste Fehlstellen, Verschmutzungen oder Spritzer eindeutig sichtbar. Diese werden dann entweder als Fehler klassifiziert oder liefern wertvolle Indikatoren, um den Prozess des Lackierens weiter zu op-



Das Viscom S3088 CCI Inspektionssystem prüft den Schutzlack elektronischer Baugruppen

timieren“, so Detlef Beer weiter. Auf diese Weise stellt die Viscom S3088 CCI sicher, dass Elektronikfertiger die IPC-CC-830-Richtlinie zur Qualifizierung und Leistung elektrischer Isoliermasse für Leiterplatten zuverlässig einhalten.

Durch flexible Algorithmen ist das System schnell an unterschiedliche Schutzlacke adaptierbar. Einfache Prüfprogramme sind in wenigen Minuten erstellt. Hinzu kommt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Ein S3088 CCI System ist günstiger als ein klassisches AOI-System. Damit ist das Inspektionssystem an Elektronikfertiger adressiert, die Baugruppen in großen und mittleren Stückzahlen lackieren, unter anderem aus Automobiltechnik, Luftfahrt, Industrieelektronik und Medizintechnik. ■

Viscom unterstützt Handball-Damen

Der Aufstieg in die 3. Liga ist perfekt

Erfolg wird belohnt! Nach einem tollen letzten Jahr, in dem schon die weibliche B-Jugend der HSG-Badenstedt Deutscher Handball-Jugendmeister geworden ist, kann nun die erste Damenmannschaft ihren Aufstieg in die dritte Liga feiern. Nach ihrem starken Durchmarsch in der Oberliga stehen sie zu Recht auf dem ersten Tabellenplatz. Der Aufstieg in eine höhere Liga ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Nicht nur die weite-

ren Fahrten, die höheren Startgelder und Anforderungen an die Trainerlizenzen steigen. Zusätzlich schreibt der Deutsche Handballbund (DHB) vor, dass bei jedem Team eine technische Mindestausrüstung vorhanden sein muss. Damit der Aufstieg nicht an den fehlenden Mitteln scheitert, hat Viscom die Mannschaft der HSG Badenstedt mit einem vierstelligen Betrag für Investitionen in technische Geräte finanziell unterstützt. Viscom hofft,



Die jungen Damen der HSG Badenstedt danken dieser Unterstützung für die Mannschaft, die Daumen drückt, dass sich der Erfolg der vergangenen Jahre fortsetzt. ■

Viele Kinder – viele interessante Projekte

Viscom ist Gastgeber des Wettbewerbs KiWiZ-Forscherpreis 2013

Am 21.06. wurde es in der Viscom-Zentrale in Hannover bunt und laut. An diesem Tag fand der Forscherpreis-Wettbewerb des hannoverschen Vereins Kind-Wissen-Zukunft (KiWiZ e. V.) statt. Über 80 Kinder bevölkerten das Foyer und stellten mit viel Spaß und Leidenschaft ihre Projekte vor.

Der Verein wurde im Jahre 2008 mit dem Ziel gegründet, Kinder und Jugendliche für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern.

Ein zentrales Element der Initiative sind die speziell konzipierten Technik-Baukästen, mit denen die Kinder in Grundschulen und Kindergärten mit viel Spaß und Unterstützung der Lehrkräfte technische Projekte entwickeln und realisieren. Ein-

mal im Jahr findet ein großer Wettbewerb statt, bei dem zu Aufgabenstellungen aus den Bereichen Bau-, Fahrzeug- und Elektrotechnik ein eigenes Produkt gebaut wird. Die jeweils besten Projekte werden dann für den KiWiZ-Forscherpreis angemeldet. Insgesamt achtzehn Projekte – doppelt so viele wie im vergangenen Jahr – präsentierten sich schließlich bei Viscom den kritischen Augen der Jury.

Volker Pape, Viscom-Vorstand und Jurymitglied, war ganz begeistert von den zahlreichen Ideen der Kinder.

„Die Vielfalt der Arbeiten der Teilnehmer am KiWiZ-Forscherpreis hat mich genauso beeindruckt wie die Qualität. Die Kinder haben mit viel Kreativität, aber auch mit echtem ‚Engineering‘ gezeigt, dass mehr



Der Hannoversche Verein Kind-Wissen-Zukunft e.V. zu Gast bei der Viscom AG

in ihnen steckt, als manche vermuten. Ich freue mich, dass sich auch viele Schulen und Lehrer an der Idee begeistern können, Kinder im Grundschulalter spielerisch mit Technik vertraut zu machen. Wir werden dieses Engagement über KiWiZ und den Förderpreis auf jeden Fall weiter unterstützen.“ ■

Firmenlauf stärkt das „Wir“-Gefühl in Unternehmen

Viscom bleibt fit

„Laufen Sie Ihrem Chef davon...!“ ist das Motto des Firmenlaufs in Hannover. Am 31. Mai 2013 fand dieser bereits zum 9. Mal statt und war mit 3650 Teilnehmern gut besucht. Auch ein Viscom-Team war dabei und nutzte die Gelegenheit, gemeinsam die Laufschuhe zu schnüren und gegen andere Teams anzutreten.

Die Strecke wurde dieses Jahr aufgrund des Hochwassers gegenüber den Vorjahren verändert und war 7 km lang. Der Firmenlauf-Oscar geht an die Gruppe mit den meisten Teilnehmern und dem kreativsten Outfit und nicht an die, die als erstes ins Ziel kommen.

Um 18 Uhr ging es los in der Mehr-



Das Viscom Team beim Firmenlauf Hannover

kampfarena des Sportparks Hannover. Nachdem das Wetter am Nachmittag nicht so recht mitspielen wollte, besserte es sich pünktlich zum Startschuss um 18.30 Uhr.

Das Viscom-Team hatte viel Spaß, auch wenn es für eine Trophäe noch nicht gereicht hat. „Aber vielleicht



wächst die Gruppe im Laufe der Jahre weiter an“, wünscht sich der begeisterte Firmenlauf-Teilnehmer Michael Mügge. „Das Beste an der Veranstaltung ist, dass nicht die Leistung, sondern der Teamgeist im Vordergrund steht und in dieser Disziplin haben wir Kollegen von Viscom sicherlich eine Medaille verdient.“

Nach dem Lauf war jedoch noch nicht alles vorbei, denn die Veranstalter hatten für ausreichend Verpflegung gesorgt. So wurden auch beim netten Beisammen-sein schon wieder Pläne geschmiedet für den 10. Firmenlauf im nächsten Jahr. ■

Viscom Technologie Forum und Anwendertreffen

Save the date

Seien Sie am 19./20. März 2014 mit dabei: Viscom lädt zum Technologie-Forum und Anwendertreffen wieder nach Hannover ein. Die Veranstaltung

wird von hochkarätigen Referenten geprägt, die einen Überblick über die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Elektronikfertigung bieten. ■



Impressum

Verantwortlicher Herausgeber:

Viscom AG

Carl-Buderus-Str. 9 -15

30455 Hannover

Tel.: +49 511 94996-0

Fax: +49 511 94996-900

info@viscom.de

www.viscom.de

Redaktion:

Martina Engelhardt

Tel.: +49 511 94996-531

Gestaltung und Layout:

Gaby Reglitz